

國立高雄師範大學職業衛生風險評估表

系所：光通系

實驗室名稱：微波與天線實驗室

填報日期：103/1/9

實驗室作業流程概要內容：

(含實驗方法、程序、儀器設備機具、材料等)

使用電腦通過程式畫出電路圖面->將電路圖面利用感光方式顯影在電路板上->電路板經蝕刻機蝕刻->裁切電路板、焊接接頭->量測

危害鑑別與風險評估表

附表	(附表一)										(附表二)				(附表三)
	(第1項)	(第2項)	(第3項)			(第4項)	(第5項)	(第6項)		風險評估				風險等級	
項次	區域/設備/作業	作業步驟	狀況			安全衛生危害因子說明	災害類型	現有風險控制方法		嚴重度 S	危害發生 機率 P	風險控制 成效 C	風險 R=S×P×C		
			例行	非 例行	緊急			軟體	硬體						
1.	實驗室廢液暫存區(氯化銅)	廢液分類存放	√			吞食有毒 對水生生物有害並具有長期持續影響	化學品洩漏	教育訓練	防止洩漏裝置	8	2	0.2	3.2	E	
2.	焊接設備	焊接	√			操作不當可能發生燒燙傷	與高/低溫接觸	自動檢查/工作安全教導	無	4	1	0.8	3.2	E	
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															

填表人員：陳佳鴻

實驗場所負責人：陳弘典

系所主管：黃世巨